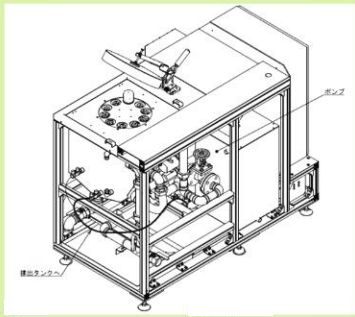


廃はんだペースト容器洗浄 と金属回収装置

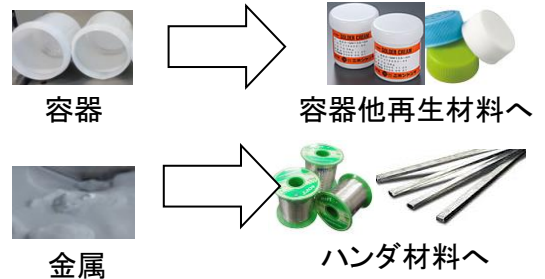
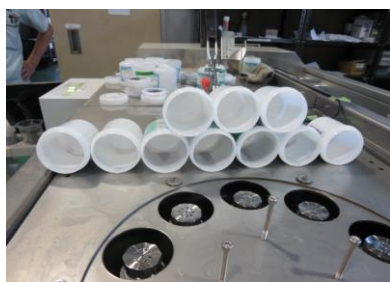
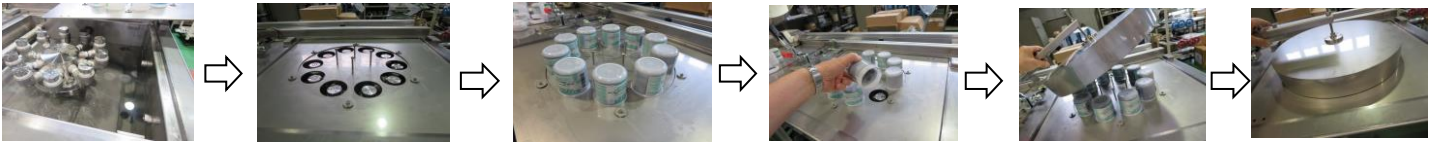
d



環境に配慮した
リサイクル装置



基盤の実装工場で使用されるクリーム半田（ハンダペースト）は開封すると時間と共に溶剤が揮発し、ペーストの性能が低下することから、ハンダ不良を起こさないために一定の時間経過後廃棄されます。この装置は東北大学と電子実装.com社、JMPエンジニアリング社が共同開発した装置です。洗浄後の容器を再生すると共に洗い出した金属粉を再度ハンダとして再利用いたします。従来の様に燃焼による有毒ガスを伴う金属取り出しでなく熱をかけずに分離回収する環境に優しい装置です。



洗浄装置

溶剤再生装

①で使用した洗浄剤は②で蒸留再生し何度でも利用できます。揮発して減少した溶剤は新しいものを追加して使用します。

装置概要

- ・処理能力 : 10個/2分~3分
- ・仕様溶剤 : はんだペースト洗浄剤WS-2965 (化研テック社製) 再生利用の場合 通常はマスク洗浄剤の利用
- ・溶剂量 : 40リットル(洗浄時)
- ・溶剤使用量 : リサイクル利用 WS-2965の時
- ・仕様電力 : 200V単層 2.5Kw
- ・エア : 0.5MPa
- ・サイズ : H=1077 W=1500 D=762

企画・販売

JMPエンジニアリング 株式会社

〒192-0363 東京都八王子市別所二丁目29-4-804
TEL:042-306-7818 FAX:042-674-5285

代理店